



(0.80 mm) .0315"

HSEC8-120-01-L-RA

HSEC8-160-01-L-RA-BL

HSEC8-RA SERIES

RIGHT-ANGLE EDGE RATE® CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?HSEC8-RA

Insulator Material:

Black Liquid Crystal Polymer

Contact:

BeCu

Plating:

Au or Sn over

50 μ" (1.27 μm) Ni

Current Rating:

2.6 A per pin

(2 adjacent pins powered)

Operating Temp:

-55 °C to +125 °C

RoHS Compliant:

Yes

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (10-60)

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

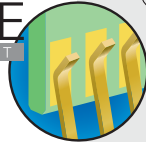
- Other platings

Card Mates:
(1.60 mm) .062" thick card,
HSC8

Cable Mates:
ECDP

EDGE
RATE
CONTACT

Rugged
Edge Rate®
contacts
designed for
Signal Integrity



Optional
Board
Locks

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

HSEC8-RA

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com
or contact SIG@samtec.com

28
Gbps

Accepts (1.60 mm) .062"
PCB thicknesses

RUGGEDIZED
BY SAMTEC

- Board lock option

HSEC8

1

POSITIONS
PER ROWCARD
THICKNESSPLATING
OPTION

RA

OTHER
OPTION

09, 10, 13, 20, 25,
30, 40, 49, 50, 60

-01
= (1.60 mm) .062"
thick card

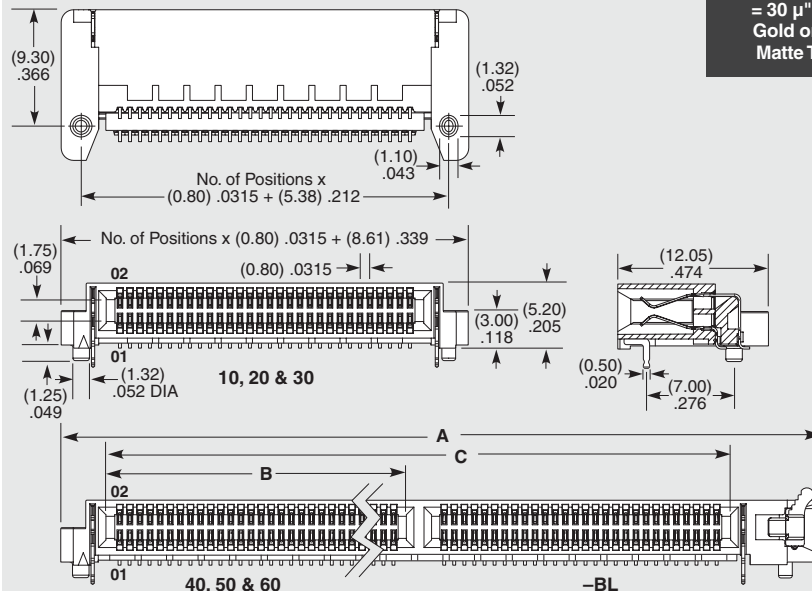
-L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

-S
= 30 μ" (0.76 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

-BL
= Board Locks
(09, 13, 25, 40,
49, 50, 60 only)

-L2
= ECDP Latching
(09, 13, 25,
49 only)
(For use with
ECDP)

-TR
= Tape & Reel
Packaging
(10 thru 60
positions only)



POSITIONS PER ROW	A	B	C
40	(43.80) 1.724	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50	(51.80) 2.039	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60	(59.80) 2.354	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071
40-BL	(51.30) 2.020	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50-BL	(59.30) 2.335	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60-BL	(67.30) 2.650	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071

Notes:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.